

MCPC TR-004 Ver1.0
Bluetooth Multi-Profile
テクニカル リファレンス

2005 年 1 月 28 日

Mobile Computing Promotion Consortium

(MCPC)

変更履歴

Version	変更内容	変更日	変更者
Draft	発行	2004年7月21日	株式会社 東芝
V0.1	マルチデバイス対応他	2004年8月24日	株式会社 東芝
V0.2	前提条件の明確化	2004年9月21日	株式会社 東芝
V0.3	1. はじめに(仕様化の目的)を MCPC HF-SWG 合意内容に修正	2004年9月27日	株式会社 東芝
V0.4	以下の記載を追記. ・DUN 起動の記述を追記. ・HFP 切断時の注意事項を追記.	2004年11月12日	株式会社 東芝
V0.5	以下の記載を追記. ・HF は Profile 起動時に SDP 要求. ・HFP 切断時ユーザ確認可能な表示を行う. ・SDDB の動的な変更は AG の実装依存.	2004年11月22日	株式会社 東芝
V1.0	V1.0として正式リリース	2005年1月28日	株式会社 東芝

目次

目次.....	3
1. はじめに	4
2. マルチプロファイルシーケンス	6
2.1 ハンズフリー機器(HF)からの HFP 接続確立	6
2.2 携帯電話(AG)からの HFP 接続確立.....	6
2.3 HFP 確立後の DUN 接続(マルチプロファイルサポートの場合)	7
2.4 HFP 確立後の DUN 接続(マルチプロファイル非サポートの場合).....	8
2.5 DUN 切断(マルチプロファイルサポートの場合)	9
2.7 HFP 接続時のリンクロス	10
2.8 DUN 接続時のリンクロス(マルチプロファイルサポートの場合)	10
2.9 DUN 接続時のリンクロス(マルチプロファイル非サポートの場合).....	10
参画メンバー	11

1. はじめに

本ドキュメントは、Bluetooth Special Interest Group(SIG)が規格する Profile のマルチプロファイル動作を規定することを目的とする。マルチプロファイルといっても、考え方によっては多種多様になることから、ここでは下記の 3 段階のステップを踏んで作業を行っていくこととする。

レベル 1:

- 同一デバイス間のマルチプロファイル。
- Profile は HFP(Hands Free Profile)と DUN(Dial-Up Network Profile)。
- 可能な限り HFP は常時接続状態とする。
- 既存のシングルプロファイル動作の製品との互換性確保。
- 既存のマルチプロファイル動作の製品との互換性確保。
- SDDB(Service Discovery Protocol Database)で公開するサービスの限定。
- 上記の準正常系、異常系のシーケンス

レベル 1 の作業に際してレベル 2、レベル 2.5、レベル 3(特にレベル 2)のシーケンスに与える影響も可能な限り考慮して作業を行う。

レベル 2:

- HSP(HeadSet Profile)と HFP の切り替え動作
- HFP と HFP の切り替え動作

レベル 2.5:

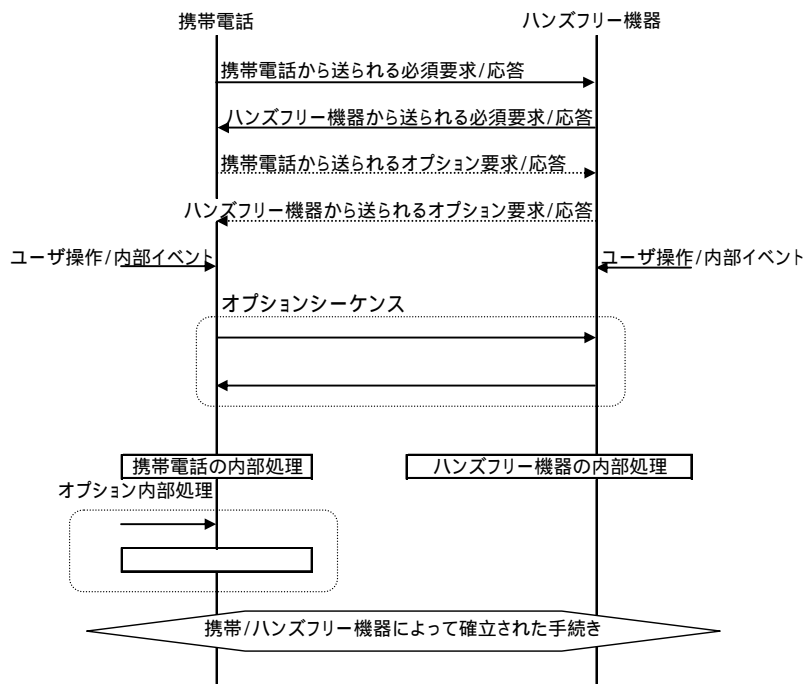
- HFP、DUN 以外の Profile(Ex. OPP、BIP、UDP)のサポート。
- マルチコールのサポート

レベル 3:

- マルチデバイス間のマルチプロファイル。
- Scatternet をサポートしたマルチプロファイル。

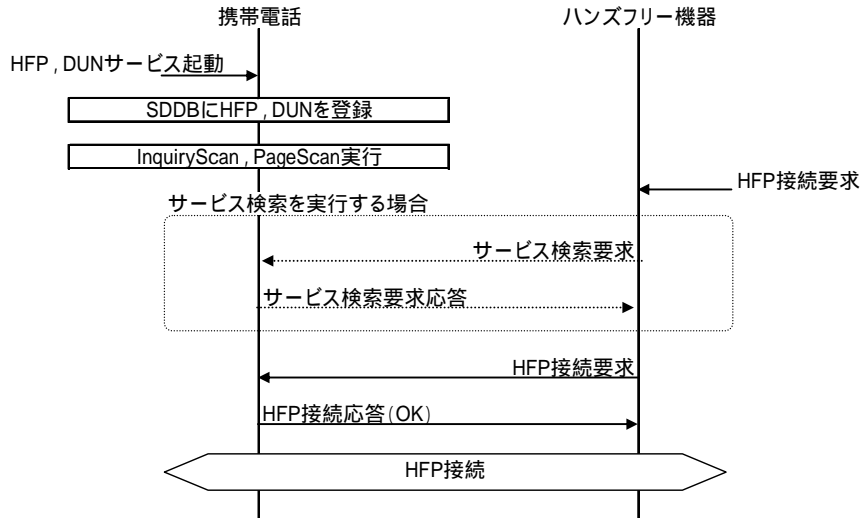
レベル 2 の仕様 FIX の目標は 05/3E とする。レベル 2.5、レベル 3 については別途。

シーケンス図の表記規則

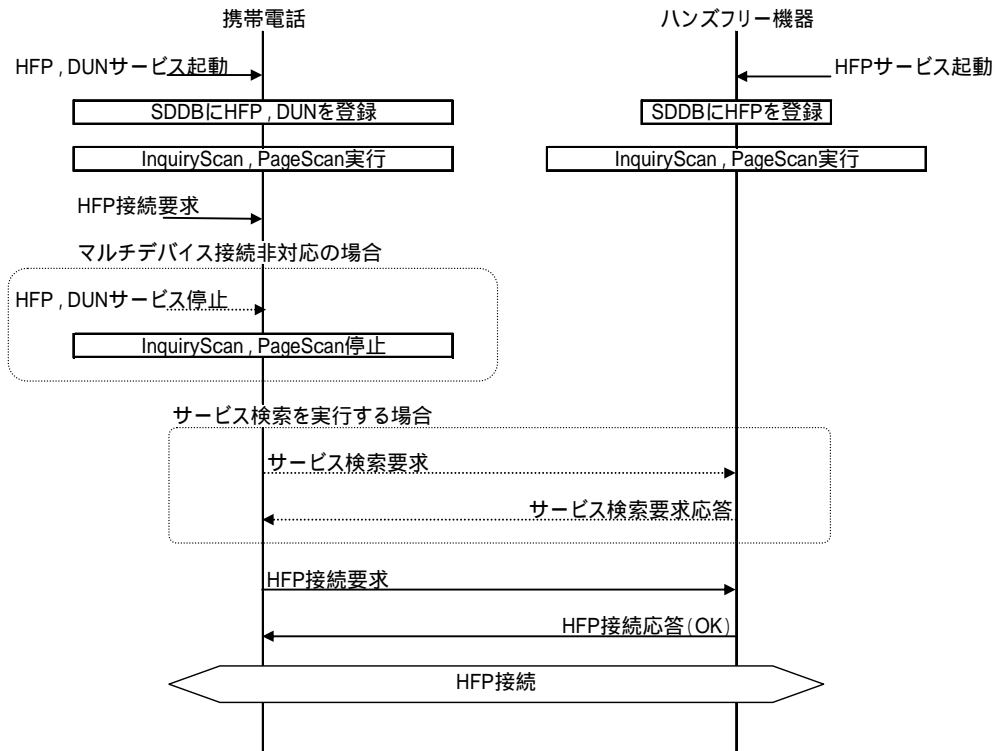


2. マルチプロファイルシーケンス

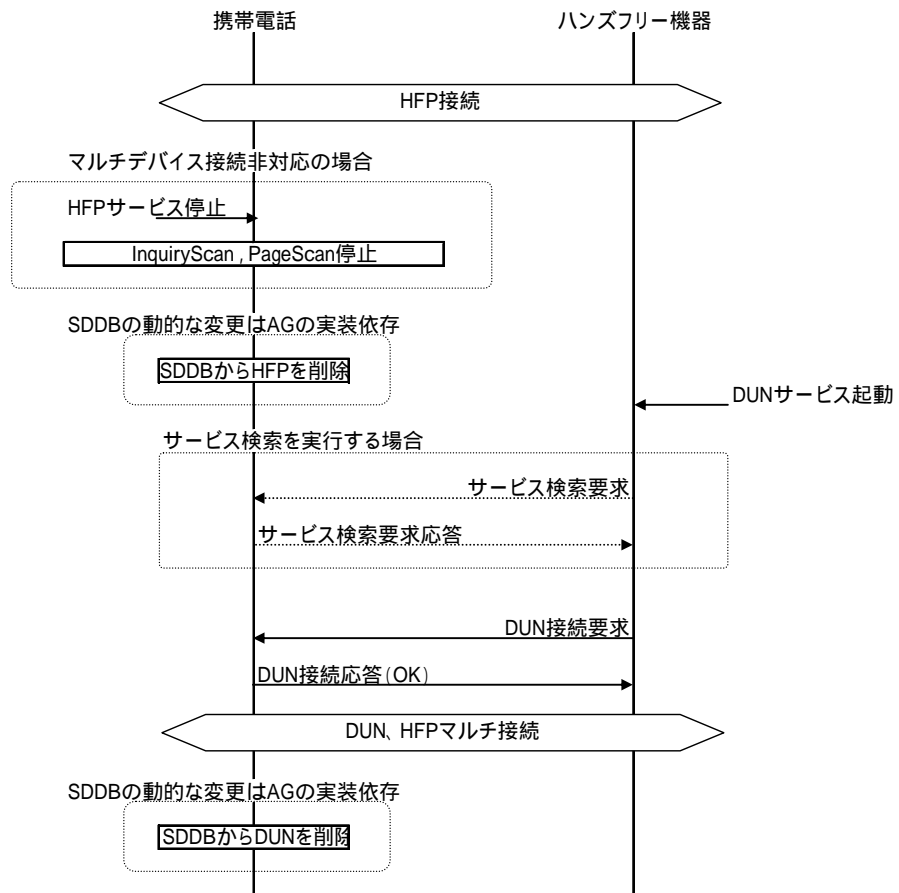
2.1 ハンズフリー機器(HF)からの HFP 接続確立



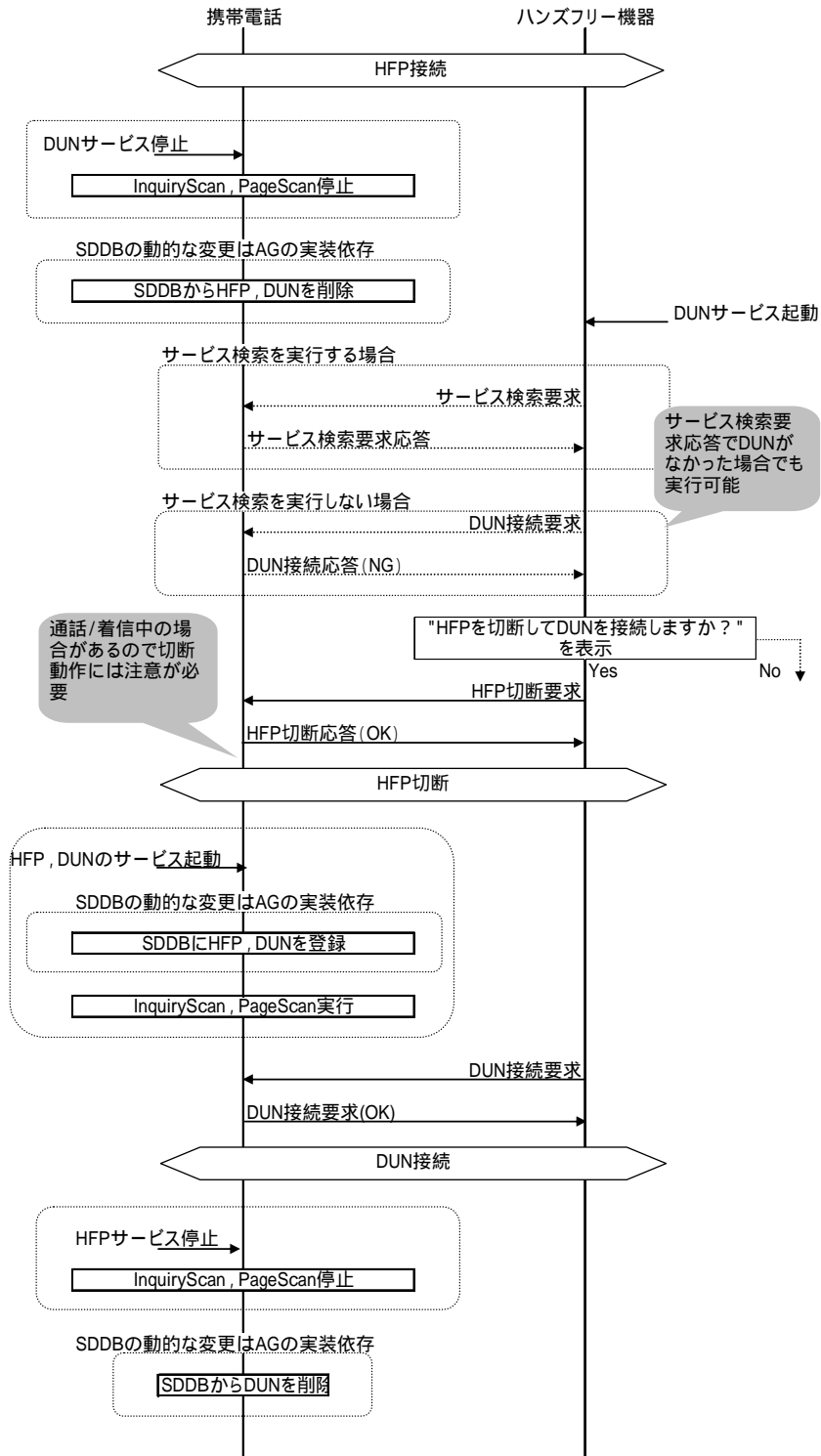
2.2 携帯電話(AG)からの HFP 接続確立



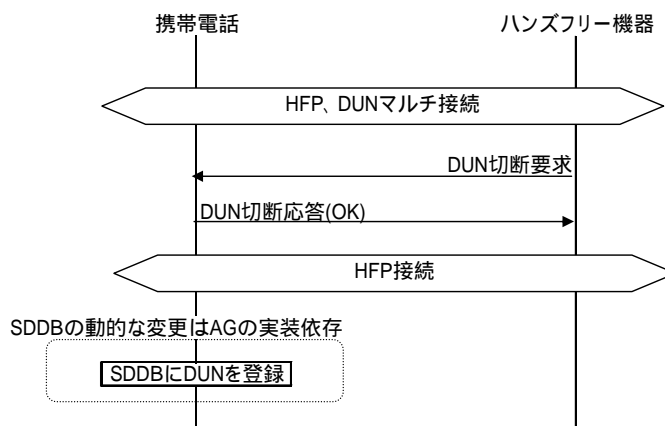
2.3 HFP 確立後の DUN 接続(マルチプロファイルサポートの場合)



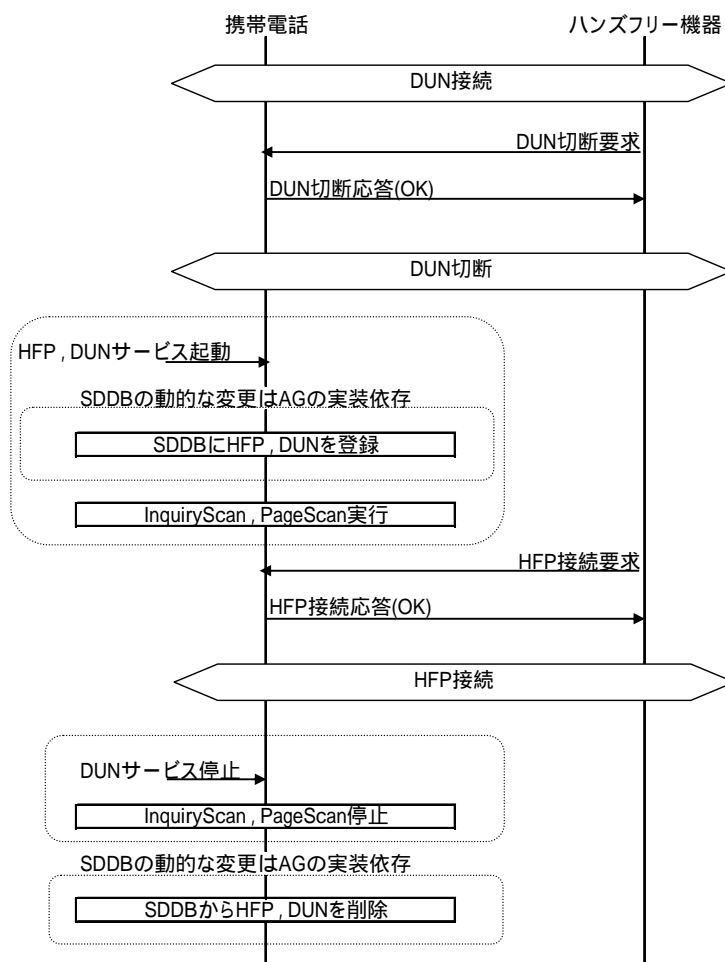
2.4 HFP 確立後の DUN 接続(マルチプロファイル非サポートの場合)



2.5 DUN 切断(マルチプロファイルサポートの場合)



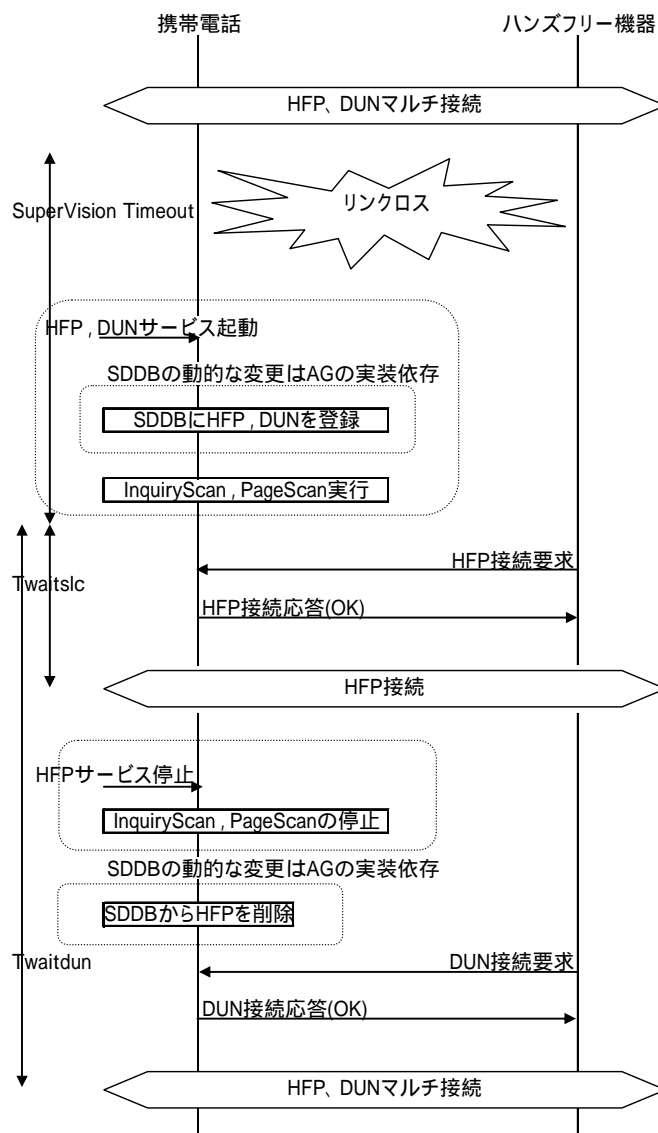
2.6 DUN 切断(マルチプロファイル非サポートの場合)



2.7 HFP 接続時のリンクロス

T.B.D.(CCAP で規定されているシーケンス)

2.8 DUN 接続時のリンクロス(マルチプロファイルサポートの場合)



2.9 DUN 接続時のリンクロス(マルチプロファイル非サポートの場合)

T.B.D.(HFP 接続に戻る or DUN のリンクロス復旧処理)

参画メンバー

浅井信樹	アルパイン株式会社
玉津保治	オープンインターフェース株式会社
渋谷彰	株式会社 NTT ドコモ
覚野浩介	株式会社 NTT ドコモ
三浦雅司	株式会社デンソー
斎藤創一	株式会社デンソー
棚田東作	株式会社東芝
田村俊哉	株式会社東芝
松谷寛	株式会社東芝
江島信昭	株式会社日立製作所
樋口基久	株式会社日立製作所
大野卓一	キャノンアイテック株式会社
鈴木誠一	クラリオン株式会社
佐藤健	KDDI 株式会社
澤木一彦	Johnson Controls ASG Japan
安田光義	ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
加藤博史	太陽誘電株式会社
山崎真一	パイオニア株式会社
小西昭男	富士通株式会社/富士通デバイス株式会社
高橋伸久	富士通株式会社/富士通デバイス株式会社
中島雅彦	富士通株式会社/富士通デバイス株式会社
蔭山弘	ボーダフォン株式会社
西川秀一	三菱電機株式会社
森本裕之	三菱電機株式会社

MCPC TR-004 Ver.1.0

Bluetooth Multi-Profile

Technical Reference

平成 17 年 1 月 28 日

発行元: モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-12 芝公園真田ビル

本書の一部または全部を無断で複製(コピー)することは著作権及び出版者の権利侵害となります。本書からの転載は原則禁止です。他の書籍等に転載する場合はモバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)の許可を必ず得てください。